Analyst 김중배 kjb6551@hmsec.com

엠케이전자 (033160O)

NDR 후기: 예상보다 더 좋은 흐름

BUY **TP 40,000원**

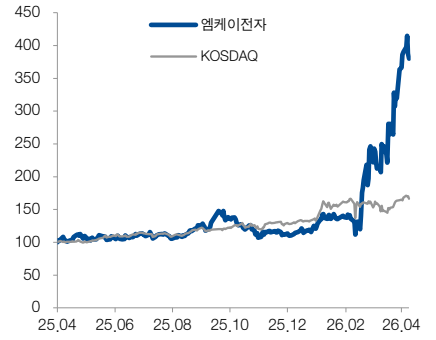
현재주가 (4/30)	27,900원
상승여력	43.4%
시가총액	671십억원
발행주식수	24,054천주
자본금/액면가	11십억원/500원
52주 최고가/최저가	30,450원/7,420원
일평균 거래대금 (60일)	22십억원
외국인 지분율	8.21%
주요주주 지분율	
오션비홀딩스외 2 인	33.41%

주가상승률	1M	3M	6M
절대주가(%)	77.7	176.5	198.7
상대주가(%p)	65.0	166.6	123.2

* K-IFRS 별도 기준

(단위: 원)	EPS(26F)	EPS(27F)	T/P
Before	1,194	1,801	40,000
After	1,194	1,801	40,000
Consensus	1,179	1,788	40,000
Cons. 차이	1.3%	0.7%	0.0%

최근 12개월 주가수익률



자료: FnGuide, 현대차증권

투자포인트 및 결론

- Memory Super-Cycle에 따른 Wire Bonding 강력한 수요는 지속되고 있고, **이는 국내 Memory사뿐 아니라 글로벌 OSAT 업체들의 수요를 통해 확인할 수 있는 대목임. 특히 금번 NDR을 통해서 확인할 수 있었던 것은 이미 강력한 국내 별도 법인만큼 중국법인의 실적 성장세가 더욱 뚜렷**하다는 것임. Memory 수요 호조에 더해 매분기 실적이 증가하며 이러한 수요 강세가 적어도 AI Cycle이 종료되기 전까지는 이어질 것으로 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 40,000원 유지하며, IT 중소형 주 Top-Pick 및 강력한 비중확대 의견 제시

주요이슈 및 실적전망

- **투자포인트 1) 국내 법인: 강력한 Memory 수요 호조 지속**

1Q26 Wire Bonding 수요는 월 7만 km 내외 수준으로 지난해 상반기까지 월 5만 km수준(Gold 기준)이었던 것을 감안한다면 급격한 성장세가 지속. 4월 수요를 감안하였을 때, 2Q25에는 QoQ +10-15% 증가한 월 8만km 수요가 Base가 될 것으로 보임. **2H26부터 SOCAMM2 수요가 반영된다고 하면 3Q26까지는 수요 증가세가 거의 확실시될 것이고, 4Q26 역시 연말 재고조정을 감안하더라도 최소한 상반기 수준의 수요는 예상. 내년부터는 SOCAMM2의 수요 확장에 따라 Gold Wire는 최소 월 10만 km 수준에 달할 것으로 예상**되고, 만약 SOCAMM2이 확대 적용된다면 과거 수요 Peak인 15만 km 이상까지 확대 기대. 국내 법인의 강력하고 견고한 성장 흐름 전망

- **투자포인트 2) 중국 법인: 중국 OSAT의 강력한 수요와 우수한 Product Mix**

국내 법인보다 수요 상황과 수익성 모두 더 강력한 것은 오히려 중국법인임. **지난해 월 20만 km 내외였던 수요는 1Q26 월 평균 24만km, 2Q26에는 27만km으로 확장되며, 3Q26에는 월 30만km를 상회할 것으로 예상. 여기에 더해 도금 Copper Wire의 높은 비중으로 인해 수익성 역시 높은 상황이며 향후에도 Mix로 인해 수익성은 더욱 개선**될 것으로 보임. 중국법인의 주요 고객사인 중국 대형 OSAT는 글로벌 Top 10 수준에서 현재는 글로벌 Top 5 수준까지 빠르게 성장. 이들은 최선단 공정보다는 Legacy 중심의 비메모리 대량 양산에 집중하고 있으며 이로 인해 Wire Bonding의 수요가 빠르게 확장되고 있는 상황임. 중국 법인의 빠른 성장세에 주목할 필요가 있음

- **투자포인트 3) 낮은 수익성은 신사업과 도금 와이어 확장으로 해결될 시간문제**

국내 별도 법인은 높은 Gold Wire 매출 비중으로 인해 수익성이 저조해 보일 수밖에 없음. **다만, 동사는 Cycle에 상관없이 Gold는 판가 전이에 따라 수익성을 유지할 수 있음. 즉, 산업이 만약 Down-Cycle에 진입하더라도 수익성은 최소한 유지된다는 것. 또한, 올해는 Pd Alloy, 내년부터는 Paste 사업의 확장으로 수익성은 지속해서 개선될 것임. Ag 기반의 도금 와이어가 추후 확대 적용된다면 Wire Bonding의 수익성은 향후 대폭 개선될 것으로 보임.** 빠른 외형 성장에 따라 이익은 같은 속도로 개선될 것이며, 수익성 역시 지속 개선됨에 따라 향후 이익 성장은 더욱 가팔라질 것. 이는 결국 Multiple에 대한 시장의 고민에 대한 해답이 될 수 있는 대목

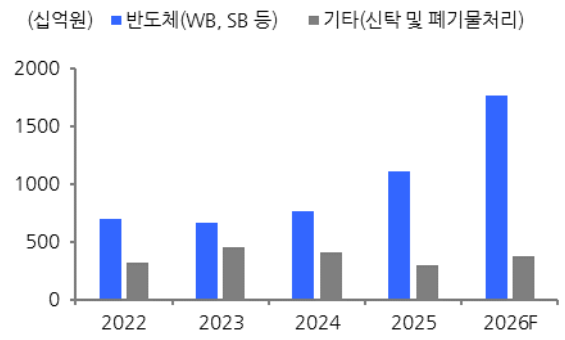
주가전망 및 Valuation

- 단기 주가 상승보다 중요한 것은 동사의 주가가 여전히 저평가되어 있다는 것임. **현재 AI Value-Chain 내에서 FC-BGA, PCB, MLCC뿐 아니라 Solder Ball, Drill bit 업체들은 최소 26F P/E 기준 20-30배 수준에서 Valuation이 형성되어 있음. 동사의 성장세는 이 Value-Chain 속에서 결코 뒤쳐지지 않고, 오히려 단기 실적에서부터 증명하며 가파른 성장세가 예상**. EPS와 Multiple은 지속해서 확장될 수 있는 국면이고, 단기 실적을 통해 이러한 흐름을 확인할 수 있을 것. 기존과 마찬가지로 반도체 부분 Target P/E 18.5배와 더불어 SOTP 적용한 목표주가 40,000원 산출

구분	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EBITDA (십억원)	EPS (원)	증감율 (%)	P/E (배)	P/B (배)	EV/EBITDA (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2024	556	10	-5	15	-224	적전	N/A	1.1	25.2	-3.6	1.5
2025	795	17	5	21	245	흑전	34.3	1.3	20.2	3.9	1.4
2026F	1,369	40	28	44	1,194	387.6	23.4	4.0	17.1	18.1	0.5
2027F	1,866	59	43	63	1,801	50.8	15.5	3.2	10.9	22.8	0.5
2028F	2,361	80	63	84	2,633	46.2	10.6	2.5	5.7	26.3	0.5

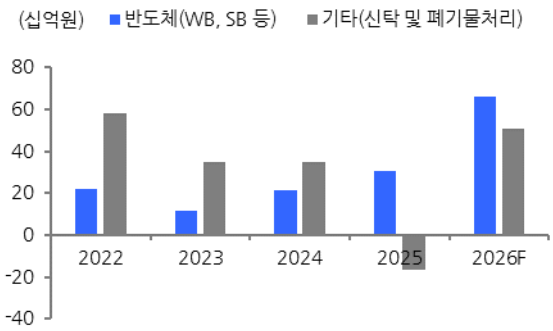
* K-IFRS 별도 기준

<그림1> 엠케이전자 사업부별 매출액 추이



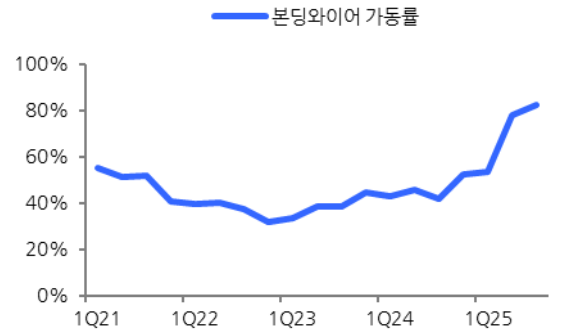
자료: 엠케이전자, 현대차증권

<그림2> 엠케이전자 사업부별 영업이익 추이



자료: 엠케이전자, 현대차증권

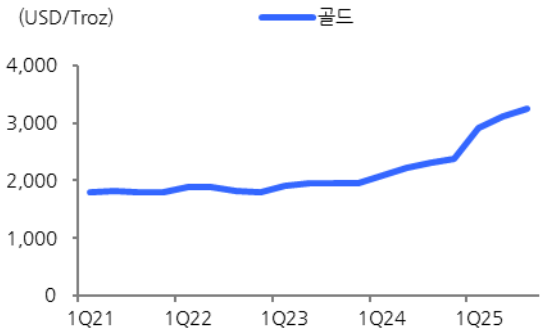
<그림3> 본딩와이어 가동률



주: 생산실적/생산능력으로 계산. 생산실적과 생산능력은 모두 금액 기준

자료: 엠케이전자, 현대차증권

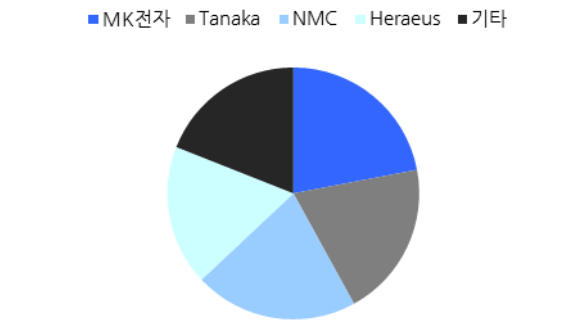
<그림4> Gold Wire 원재료



주: 원재료 가격은 평균 구매가격 기준

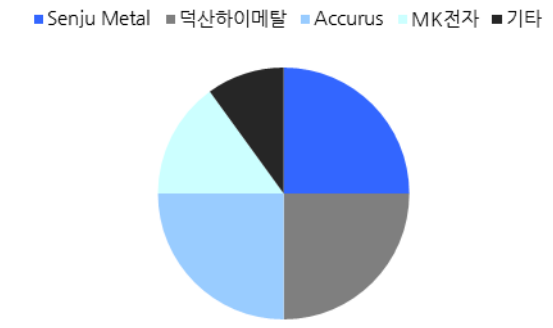
자료: 엠케이전자, 현대차증권

<그림5> 글로벌 본딩와이어 점유율



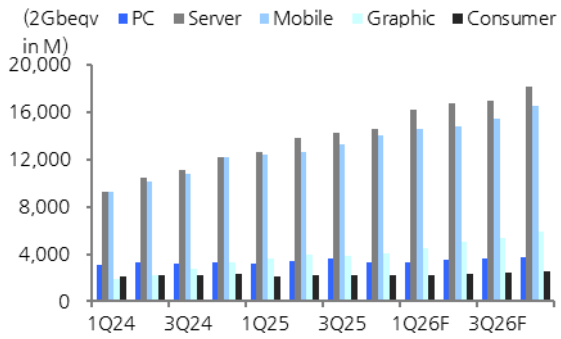
자료: 엠케이전자, 현대차증권

<그림6> 글로벌 솔더볼 점유율



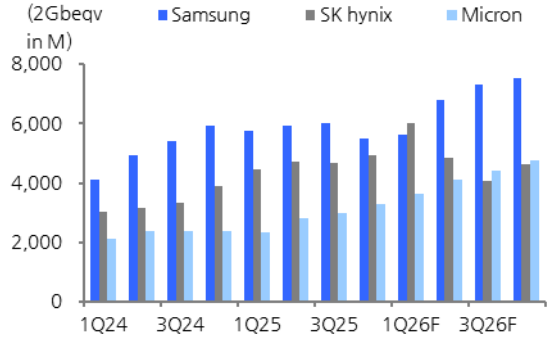
자료: 엠케이전자, 현대차증권

<그림7> 응용처별 DRAM 출하량



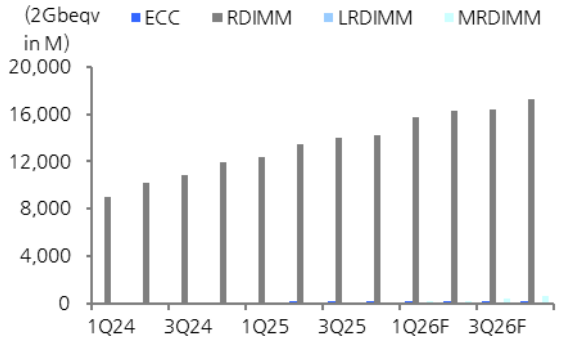
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림8> Memory 3사 Server DRAM 출하량



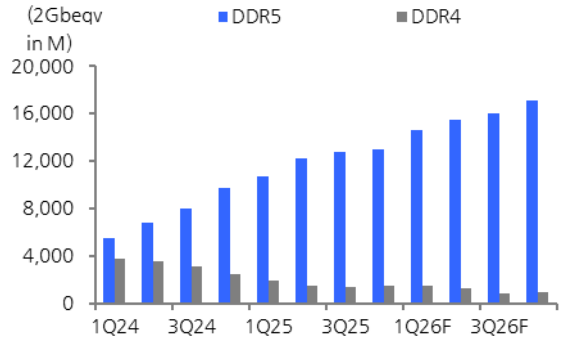
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림9> 패키지별 Server DRAM 출하량



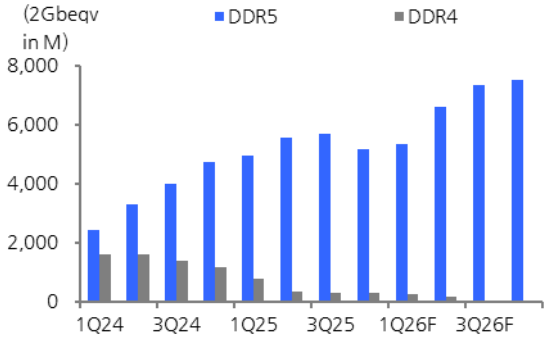
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림10> 제품별 Server DRAM 출하량



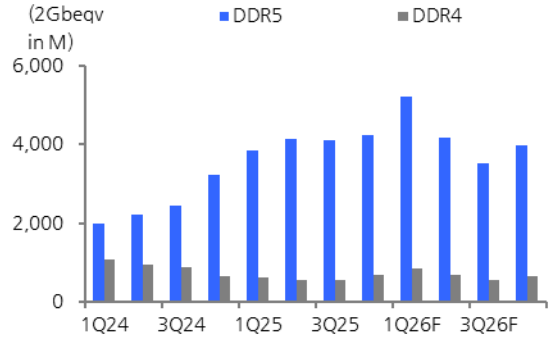
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림11> 삼성전자 Server DRAM 출하량



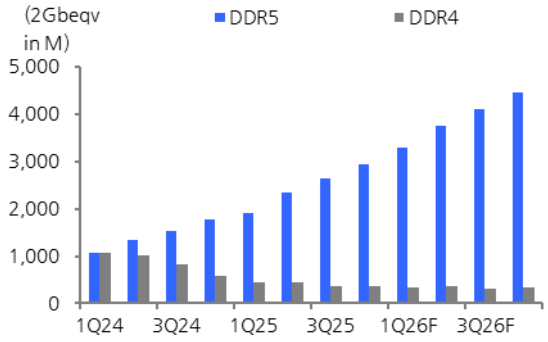
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림12> SK하이닉스 Server DRAM 출하량



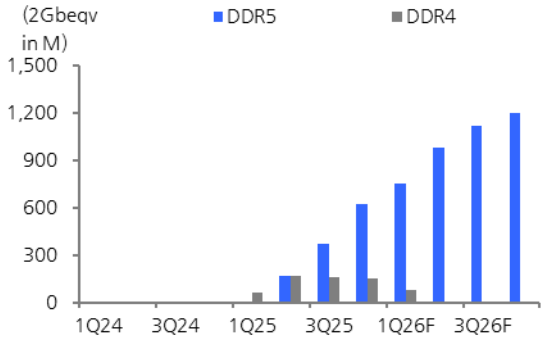
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림13> Micron Server DRAM 출하량



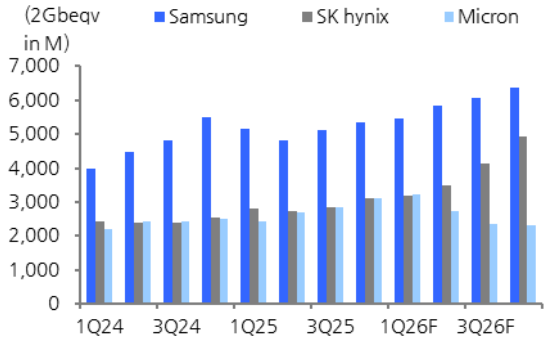
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림14> CXMT Server DRAM 출하량



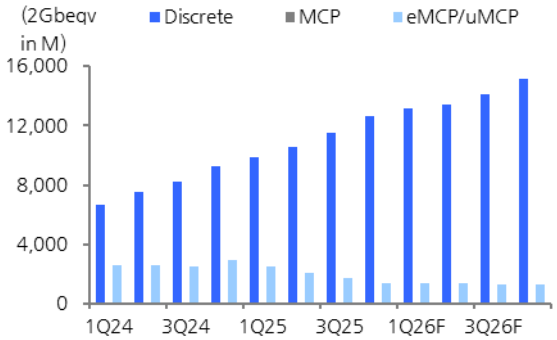
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림15> Memory 3사 Mobile DRAM 출하량



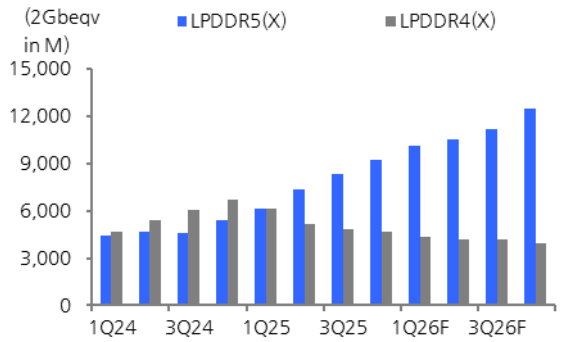
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림16> 패키지별 Mobile DRAM 출하량



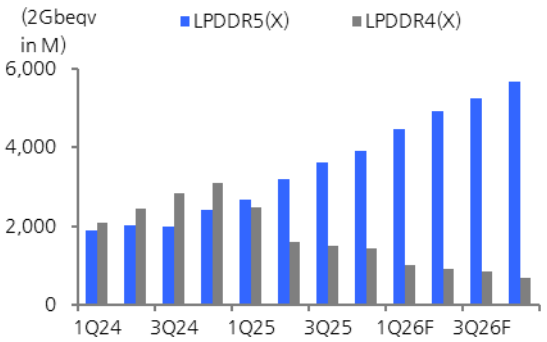
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림17> 제품별 Mobile DRAM 출하량



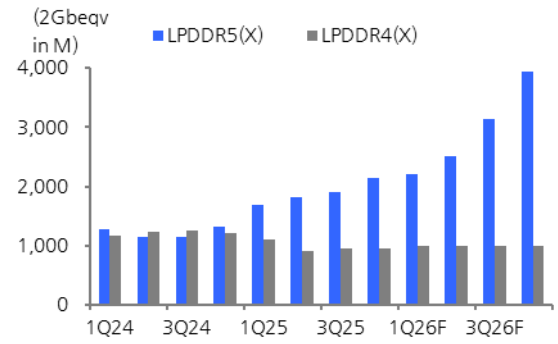
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림18> 삼성전자 Mobile DRAM 출하량



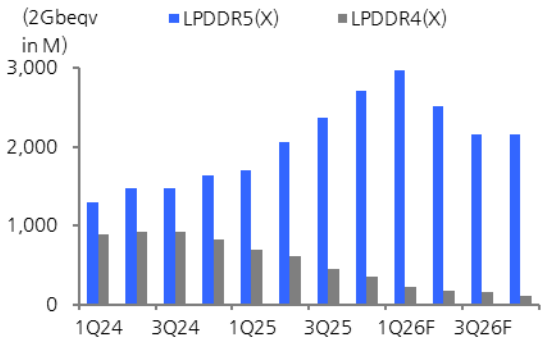
자료: Trendforce, 현대차증권

<그림19> SK하이닉스 Mobile DRAM 출하량



자료: Trendforce, 현대차증권

<그림20> Micron Mobile DRAM 출하량



자료: Trendforce, 현대차증권

<표1> 응용처별 메모리 규모 비교

구분	Smartphone	PC	AI Server
DRAM	8~16GB	16~32GB	**1~2TB**
NAND	256GB~1TB	512GB~2TB	**8~30TB**
HBM	없음	없음	**0.6~1.5TB**
메모리 원가 비중	~25%	~30%	**40~60%**

자료: 현대차증권

〈표2〉 응용처별 패키징 방식 비교

적용 영역	연결 방식	내용	Wire Bonding의 현재 위치
저핀수 아날로그 IC, PMIC, MCU, EEPROM, 인터페이스 IC	Wire Bonding	핀 수가 많지 않고 원가 민감도가 높으며, 리드프레임/QFN/DFN/QFP 계열 패키지가 경제적	주력 적용처
자동차 body / zone / lighting / sensor interface / SBC	Wire Bonding 중심	장수명·고신뢰성·원가 경쟁력이 중요하고, 중저핀 mixed-signal 칩이 많음	매우 견조
RF 모듈, connectivity module, 일부 SiP	Wire Bonding + 일부 Flip-Chip 혼합	모듈 내부에서 여러 die/passive를 저비용으로 연결하기 좋고, 필요한 곳만 flip-chip을 쓰는 혼합 구조가 효율적	여전히 중요
모바일 AP 주변부 전력/제어칩	Wire Bonding + 일부 FCOL/HotRod	일반 제어칩은 wire bond면 충분하지만, 고속 전력 경로나 EMI가 중요한 칩은 bond wire 제거가 유리	일부 대체 진행
고성능 AP, GPU, 서버 CPU, 네트워크 ASIC	Flip-Chip	I/O 수, 전기적 성능, 열 특성 요구가 높아 wire bond의 주변부 배선 구조로는 한계가 큼	대부분 대체됨
HBM, 2.5D/3D, AI 가속기 패키지	TCB / Hybrid Bonding / Advanced Packaging	초고대역폭, 초미세 피치, 짧은 interconnect가 필요	사실상 비주력
전력반도체 discrete / module	Heavy Wire / Ribbon / Clip / 일부 Wirebond-free 공존	전통적으로 wire가 강했지만, 고전력·고열·고사이클 환경에서는 clip·wirebond-free가 유리	공존 구간
산업용 파워, 충전기, 서버 전원, 중저전력 모듈	Wire / Ribbon / Clip 혼합	최첨단 traction inverter만큼의 extreme spec은 아니어서 기존 wire 계열도 경쟁력 있음	여전히 크다

자료: 현대차증권

〈표3〉 Memory 아키텍처 간 비교(DIMM vs HBM vs CAMM)

구분	DIMM / RDIMM	HBM	SoCAMM
위치	메인보드 슬롯	칩 패키지 내부	SoC 인접
대역폭	중간	매우 높음	높음 (HBM보다는 낮을 수 있음)
전력 효율	보통	매우 우수	우수
확장/교체	매우 용이	불가	제한적이나 가능
비용 구조	낮음	매우 높음	중간
주요 용도	범용 Server	AI GPU	AI SoC, 가속기, 엣지

자료: 현대차증권

〈표4〉 SCAMM1 vs SOCAMM2 스펙 비교

구분	SOCAMM1	SOCAMM2
도입 시점	2023~2024	2025~
주도 업체	NVIDIA(초기 주도), 일부 CSP	NVIDIA 차세대 플랫폼 중심
메모리 규격	LPDDR5 / LPDDR5X	LPDDR5X(고속 bin) 또는 LPDDR6(예정)
인터페이스	저전력 병렬 인터페이스	인터페이스 고속화 및 채널 확장
대역폭	SOCAMM2 대비 낮음	SOCAMM1 대비 대폭 증가
모듈 용량	수십 GB 수준	64~128GB 이상 확대
전력효율	우수	동일 전력 대비 성능 향상
적용 플랫폼	Hopper 일부 구성, Grace Hopper 초기	Blackwell(B100/B200), 차세대 Grace
역할 포지션	HBM 보조(보완 메모리)	HBM과의 계층적 메모리 구조의 핵심

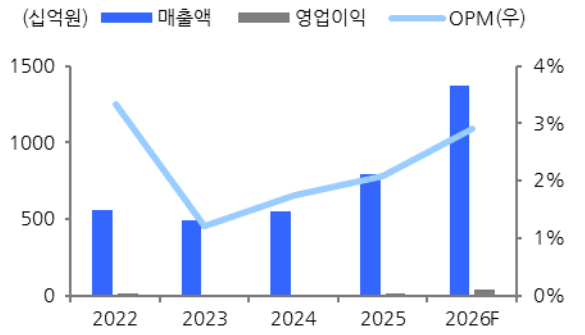
자료: 현대차증권

〈표5〉 Memory 3사 SOCAMM2 스펙 비교

	삼성전자	SK하이닉스
모듈 용량	192GB	192GB
동작 속도	8.5Gbps	7.5-9.6Gbps
메모리 규격	LPDDR5X	LPDDR5X
I/O 핀수	694개	694개

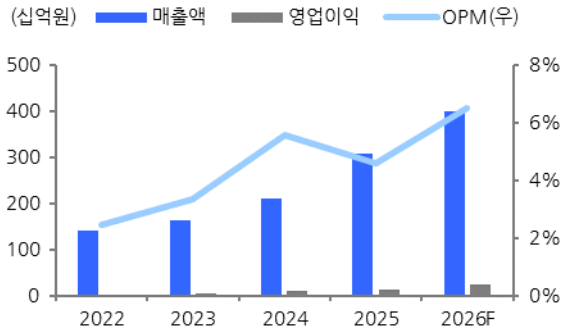
자료: 현대차증권

〈그림21〉 엠케이전자 국내법인 실적 추이



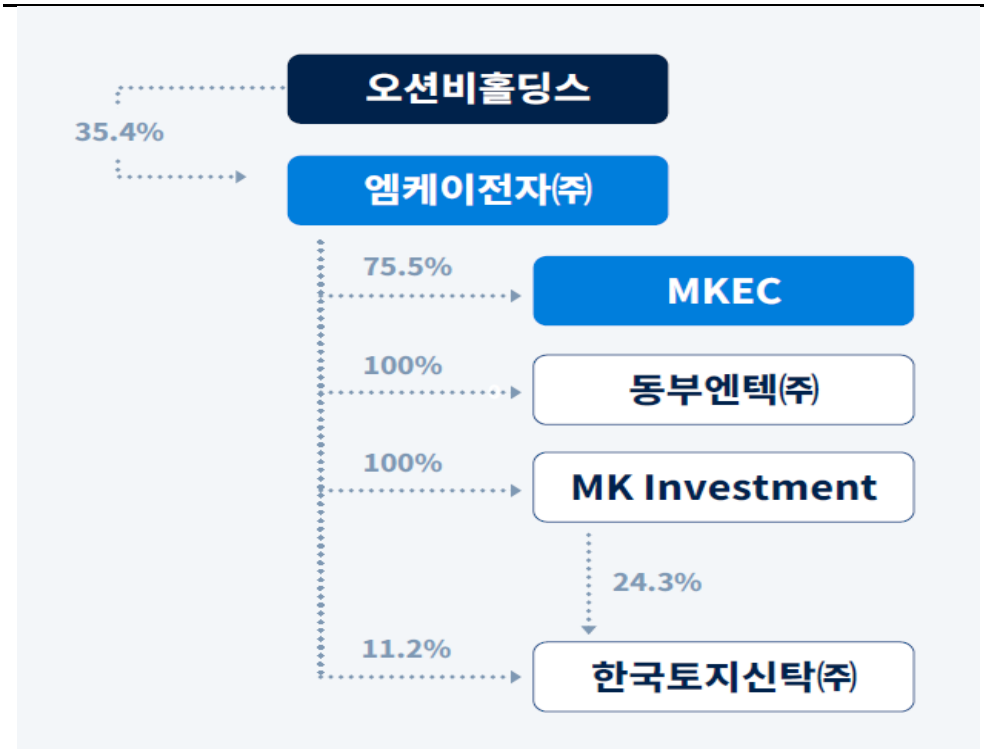
자료: 엠케이전자, 현대차증권

〈그림22〉 엠케이전자 중국법인 실적 추이



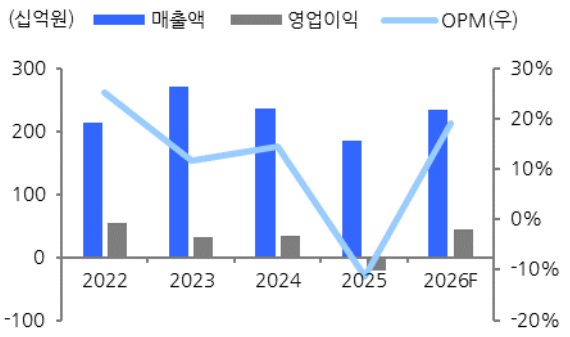
자료: 엠케이전자, 현대차증권

〈그림23〉 엠케이전자 지배구조



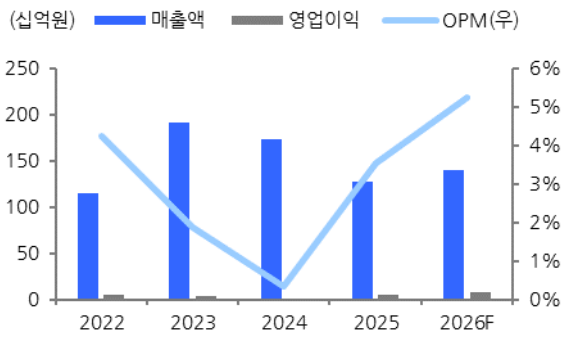
자료: 엠케이전자, 현대차증권

〈그림24〉 한국토지신탁 연간 실적 추이



자료: 엠케이전자, 현대차증권

〈그림25〉 동부엔텍 연간 실적 추이



자료: 엠케이전자, 현대차증권

〈표6〉 엠케이전자 분기별 실적 추이

(단위: 십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26F	2Q26F	3Q26F	4Q26F	2024	2025	2026F
매출액(연결)	**283.7**	**336.1**	**376.9**	**407.1**	**472.4**	**528.6**	**551.6**	**591.8**	**1,170.6**	**1,403.8**	**2,144.4**
YoY	*4.3%*	*13.9%*	*40.7%*	*21.3%*	*66.5%*	*57.3%*	*46.3%*	*45.4%*	*4.8%*	*19.9%*	*52.8%*
QoQ	*-15.5%*	*18.5%*	*12.1%*	*8.0%*	*16.0%*	*11.9%*	*4.3%*	*7.3%*			
반도체	**218.4**	**262.8**	**307.2**	**315.5**	**385.4**	**432.1**	**466.5**	**486.8**	**768.5**	**1,103.9**	**1,771.0**
국내법인(별도)	155.3	184.2	223.1	232.8	288.7	332.0	365.2	383.5	**556.0**	**795.4**	**1,369.5**
중국법인(MKEC)	63.1	78.6	84.1	82.7	96.7	100.1	101.3	103.3	**212.5**	**308.5**	**401.5**
기타	**65.2**	**73.4**	**69.8**	**91.6**	**86.9**	**96.5**	**85.0**	**105.0**	**402.1**	**299.9**	**373.4**
매출원가(연결)	**277.6**	**316.1**	**375.5**	**387.4**	**440.3**	**484.3**	**507.6**	**560.9**	**1,084.9**	**1,356.6**	**1,993.1**
(%)	*97.9%*	*94.0%*	*99.6%*	*95.2%*	*93.2%*	*91.6%*	*92.0%*	*94.8%*	*92.7%*	*96.6%*	*92.9%*
매출총이익(연결)	**6.0**	**20.1**	**1.5**	**19.7**	**32.1**	**44.3**	**43.9**	**31.0**	**85.7**	**47.3**	**151.3**
GPM	*2.1%*	*6.0%*	*0.4%*	*4.8%*	*6.8%*	*8.4%*	*8.0%*	*5.2%*	*7.3%*	*3.4%*	*7.1%*
판매관리비(연결)	**7.2**	**8.3**	**7.9**	**9.5**	**7.6**	**8.7**	**8.3**	**9.9**	**29.6**	**32.9**	**34.5**
(%)	*2.5%*	*2.5%*	*2.1%*	*2.3%*	*1.6%*	*1.6%*	*1.5%*	*1.7%*	*2.5%*	*2.3%*	*1.6%*
영업이익(연결)	**-1.2**	**11.8**	**-6.4**	**10.2**	**24.5**	**35.6**	**35.6**	**21.1**	**56.1**	**14.4**	**116.8**
YoY	*-113.2%*	*-44.6%*	*-232.0%*	*-51.9%*	*-2229.8%*	*202.7%*	*-653.0%*	*106.0%*	*20.7%*	*-74.3%*	*711.0%*
OPM	*-0.4%*	*3.5%*	*-1.7%*	*2.5%*	*5.2%*	*6.7%*	*6.5%*	*3.6%*	*4.8%*	*1.0%*	*5.4%*
반도체	**6.6**	**5.1**	**8.9**	**10.2**	**14.6**	**16.1**	**17.3**	**17.9**	**21.6**	**30.8**	**65.9**
국내법인(별도)	3.7	1.5	5.0	6.4	8.3	9.6	10.7	11.2	**9.8**	**16.6**	**39.8**
중국법인(MKEC)	2.9	3.6	3.9	3.8	6.3	6.5	6.6	6.7	**11.8**	**14.2**	**26.1**
기타	**-7.7**	**6.6**	**-15.4**	**0.0**	**9.9**	**19.5**	**18.3**	**3.2**	**34.5**	**-16.4**	**50.9**

자료: 현대차증권

<표7> 엠케이전자 Valuation 및 목표주가 산출

구분	내용	비고
엠케이전자 별도(①=axb) (억원)	**5,243**	
26F 별도 순이익(a) (십억원)	28	
Target P/E(b) (x)	18.5	과거 Wire-Bonding의 수요 전성기였던 2009년-2011년 P/E 최상단 Multiple
MKEC(중국 법인)(②) (억원)	**2,734**	별도 법인과 동일한 Multiple 적용 지분율 75.5% 반영
한국토지신탁(③) (억원)	**684**	현재 시가총액 3,853억원(4/22) 기준 지분율 35.5% 및 NAV 할인 50%
동부엔텍(④) (억원)	**200**	환경에너지 사업, 순이익 40억원 x Peer Multiple 5배 적용
시총 Total (십억원) (① +②+③+④)	886	
유통주식수 (주)	22,305,008	
목표주가 (원)	40,000	
현재주가 (원)	27,900	4/30 종가 기준
Upside Potential(%)	43.4	

자료: 현대차증권

(단위:십억원)

포괄손익계산서	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**556**	**795**	**1,369**	**1,866**	**2,361**
증가율 (%)	12.1	43.0	72.2	36.3	26.5
매출원가	**532**	**764**	**1,315**	**1,792**	**2,264**
매출원가율 (%)	95.7	96.1	96.1	96.0	95.9
매출총이익	**24**	**32**	**55**	**75**	**97**
매출이익률 (%)	4.3	4.0	4.0	4.0	4.1
증가율 (%)	33.3	33.3	71.9	36.4	29.3
판매관리비	**14**	**15**	**15**	**16**	**17**
판관비율(%)	2.5	1.9	1.1	0.9	0.7
EBITDA	**15**	**21**	**44**	**63**	**84**
EBITDA 이익률 (%)	2.7	2.6	3.2	3.4	3.6
증가율 (%)	36.4	40.0	109.5	43.2	33.3
영업이익	**10**	**17**	**40**	**59**	**80**
영업이익률 (%)	1.8	2.1	2.9	3.2	3.4
증가율 (%)	66.7	70.0	135.3	47.5	35.6
영업외손익	**-16**	**-9**	**-5**	**-4**	**-2**
금융수익	30	31	9	10	13
금융비용	47	40	14	14	15
기타영업외손익	1	0	0	0	0
종속/관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	**-6**	**8**	**35**	**54**	**79**
세전계속사업이익률	-1.1	1.0	2.6	2.9	3.3
증가율 (%)	적전	흑전	337.5	54.3	46.3
법인세비용	-1	2	6	11	16
계속사업이익	-5	5	28	43	63
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	**-5**	**5**	**28**	**43**	**63**
당기순이익률 (%)	-0.9	0.6	2.0	2.3	2.7
증가율 (%)	적전	흑전	460.0	53.6	46.5
지배주주지분 순이익	-5	5	28	43	63
비지배주주지분 순이익	0	0	0	0	0
기타포괄이익	11	1	0	0	0
총포괄이익	6	7	28	43	63

(단위:십억원)

재무상태표	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	**161**	**239**	**311**	**394**	**651**
현금성자산	5	9	49	126	344
단기투자자산	17	16	16	16	0
매출채권	78	114	139	116	141
재고자산	55	94	96	123	149
기타유동자산	6	6	10	14	17
비유동자산	**236**	**236**	**232**	**229**	**65**
유형자산	67	65	61	57	54
무형자산	0	0	0	0	0
투자자산	162	163	164	164	4
기타비유동자산	7	8	7	8	7
기타금융업자산	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자산총계	**397**	**475**	**543**	**623**	**716**
유동부채	**231**	**313**	**354**	**392**	**423**
단기차입금	201	212	212	212	212
매입채무	6	49	80	109	132
유동성장기부채	10	37	37	37	37
기타유동부채	14	15	25	34	42
비유동부채	**34**	**18**	**19**	**21**	**22**
사채	29	12	12	12	12
장기차입금	2	0	0	0	0
장기금융부채	0	3	3	3	3
기타비유동부채	3	3	4	6	7
기타금융업부채	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
부채총계	**265**	**331**	**373**	**413**	**445**
지배주주지분	132	144	170	210	271
자본금	11	11	11	11	11
자본잉여금	38	44	44	44	44
자본조정 등	-13	-12	-12	-12	-12
기타포괄이익누계액	12	12	12	12	12
이익잉여금	84	89	114	155	216
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
자본총계	**132**	**144**	**170**	**210**	**271**

(단위:십억원)

현금흐름표	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동으로인한현금흐름	**-15**	**-24**	**41**	**77**	**42**
당기순이익	-5	5	28	43	63
유형자산 상각비	5	5	4	4	3
무형자산 상각비	0	0	0	0	0
외환손익	0	1	0	0	0
운전자본의 감소(증가)	-25	-37	8	30	-25
기타	10	2	1	0	1
투자활동으로인한현금흐름	**-14**	**1**	**-1**	**-1**	**177**
투자자산의 감소(증가)	2	-0	-1	-1	161
유형자산의 감소	0	0	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-13	-3	0	0	0
기타	-3	4	0	0	16
재무활동으로인한현금흐름	**25**	**26**	**0**	**-0**	**-1**
차입금의 증가(감소)	2	1	0	0	0
사채의증가(감소)	22	-17	0	0	0
자본의 증가	4	7	0	0	0
배당금	-2	-2	-3	-3	-3
기타	-1	37	3	3	2
기타현금흐름	**0**	**-0**	**0**	**0**	**0**
현금의증가(감소)	**-3**	**4**	**41**	**76**	**219**
기초현금	8	5	9	49	126
기말현금	5	9	49	126	344

(단위:원, 배, %)

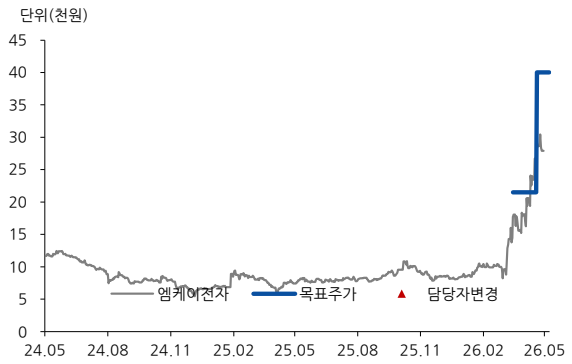
주요투자지표	2024	2025	2026F	2027F	2028F
EPS(당기순이익 기준)	-224	245	1,194	1,801	2,633
EPS(지배순이익 기준)	-224	245	1,194	1,801	2,633
BPS(자본총계 기준)	5,966	6,375	7,060	8,746	11,264
BPS(지배지분 기준)	5,966	6,375	7,060	8,746	11,264
DPS	100	120	120	120	120
P/E(당기순이익 기준)	N/A	34.3	23.4	15.5	10.6
P/E(지배순이익 기준)	N/A	34.3	23.4	15.5	10.6
P/B(자본총계 기준)	1.1	1.3	4.0	3.2	2.5
P/B(지배지분 기준)	1.1	1.3	4.0	3.2	2.5
EV/EBITDA(Reported)	25.2	20.2	17.1	10.9	5.7
배당수익률	1.5	1.4	0.5	0.5	0.5
성장성 (%)					
EPS(당기순이익 기준)	적전	흑전	387.6	50.8	46.2
EPS(지배순이익 기준)	적전	흑전	387.6	50.8	46.2
수익성 (%)					
ROE(당기순이익 기준)	-3.6	3.9	18.1	22.8	26.3
ROE(지배순이익 기준)	-3.6	3.9	18.1	22.8	26.3
ROA	-1.3	1.2	5.6	7.4	9.5
안정성 (%)					
부채비율	201.5	229.4	219.9	196.3	164.2
순차입금비율	171.7	169.3	121.3	63.1	순현금
이자보상배율	0.8	1.3	2.8	4.1	5.5

** K-IFRS 별도 기준*

▶ 투자의견 및 목표주가 추이

일 자	투자의견	목표주가	괴리율(%)	
			평균	최고/최저
2026.03.19	BUY	21,500	-8.02	25.12
2026.04.23	BUY	40,000	-27.68	-23.88
2026.05.04	BUY	40,000		

▶ 최근 2년간 엠케이전자 주가 및 목표주가



▶ Compliance Notice

- 동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 지분율 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성) 발행과 관련하여 지난 6개월간 주간사로 참여하지 않았습니다.
- 조사분석 담당자 및 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 자료작성자 김종배의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

▶ 투자의견 분류

▶ 업종 투자의견 분류 현대차증권의 업종투자의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 업종 펀더멘털과 업종주가의 전망을 의미함.

- OVERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
- NEUTRAL : 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음
- UNDERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대

▶ 현대차증권의 종목투자의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 상대수익률을 의미함.

- BUY : 추천일 종가대비 초과수익률 +15%P 이상
- MARKETPERFORM(M.PERFORM) : 추천일 종가대비 초과수익률 -15%~+15%P 이내
- SELL : 추천일 종가대비 초과수익률 -15%P 이하

▶ 투자등급 통계 (2025.04.01~2026.03.31)

투자등급	건수	비율(%)
매수	181건	93.8%
보유	12건	6.2%
매도	0건	0%

- 본 조사자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 당사의 사전 동의 없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.